



平成24年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年7月26日

上場会社名 信越化学工業株式会社
 コード番号 4063 URL <http://www.shinetsu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 森 俊三
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 笠原 俊幸
 四半期報告書提出予定日 平成23年8月12日
 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (証券アナリスト、機関投資家向け)

上場取引所 東 大 名

TEL 03-3246-5051

(百万円未満切捨て)

1. 平成24年3月期第1四半期の連結業績(平成23年4月1日～平成23年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年3月期第1四半期	250,023	△3.7	40,001	10.7	42,235	8.2	23,837	△33.2
23年3月期第1四半期	259,715	36.6	36,140	75.0	39,029	80.5	35,700	139.7

(注) 包括利益 24年3月期第1四半期 40,031百万円 (18.4%) 23年3月期第1四半期 33,812百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年3月期第1四半期	56.14	—
23年3月期第1四半期	84.08	84.07

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年3月期第1四半期	1,793,097	1,487,501	80.6	3,402.67
23年3月期	1,784,166	1,469,429	80.0	3,360.39

(参考) 自己資本 24年3月期第1四半期 1,444,758百万円 23年3月期 1,426,808百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年3月期	—	50.00	—	50.00	100.00
24年3月期	—	—	—	—	—
24年3月期(予想)	—	50.00	—	50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 平成24年3月期の連結業績予想(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	520,000	△2.4	77,000	1.1	82,000	1.0	50,000	△19.8	117.76
通期	1,065,000	0.6	155,000	3.9	165,000	2.9	102,000	1.9	240.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた記述であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績等は、様々な要素によりこれら業績見通し等とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績等に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績等に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。

4. その他

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

24年3月期1Q	432,106,693 株	23年3月期	432,106,693 株
24年3月期1Q	7,511,247 株	23年3月期	7,510,657 株
24年3月期1Q	424,595,705 株	23年3月期1Q	424,601,031 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中であります。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	P. 2
(2) 連結業績予想に関する定性的情報	P. 3
2. 四半期連結財務諸表	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 継続企業の前提に関する注記	P. 8
(4) セグメント情報	P. 8
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	P. 8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間の世界経済は、アジア地域では中国を中心に景気拡大の動きが続き、欧米では緩やかな景気の回復が見られましたが、需要家の多くが警戒を緩めない状況が続きました。日本経済は、本年3月に発生した東日本大震災の影響により、依然として厳しい状況にある中で、徐々に持ち直しの動きも見られました。

このような状況のもとで、当社グループは、世界の顧客との関係を強化し拡販に注力するとともに、経営基盤の強化、効率化や新規製品の開発に努めてまいりました。また、東日本大震災により、当社の鹿島工場、信越半導体(株)の白河工場が操業の停止を余儀なくされましたが、グループの総力をあげた取組みにより、6月末に被災した全ての生産拠点の復旧が完了いたしました。

当第1四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は、前年同期に比べ3.7% (96億9千2百万円) 減少し、2,500億2千3百万円となりました。営業利益は、前年同期に比べ10.7% (38億6千1百万円) 増加し、400億1百万円となり、経常利益も、前年同期に比べ8.2% (32億6百万円) 増加し、422億3千5百万円となりました。

また、四半期純利益は、前年同期において移転価格課税に対する日米相互協議の合意による過年度法人税等の戻り入れがあった一方、当第1四半期において東日本大震災による特別損失を計上したことなどにより、前年同期に比べ33.2% (118億6千3百万円) 減少し、238億3千7百万円となりました。

塩ビ・化成品事業

塩化ビニルは、米国シンテック社が、米国住宅市場の長期的な低迷が続く中、世界中の顧客への拡販により高水準の出荷を継続し、業績を伸長させました。オランダのシンエツPVC社も出荷が堅調に推移しました。一方、国内事業は、東日本大震災により鹿島工場の操業が停止した影響もあり、厳しい状況が続きました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ4.2% (29億3千2百万円) 減少し674億5千7百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ95.4% (29億5千8百万円) 増加し60億5千9百万円となりました。

シリコーン事業

シリコーンは、国内販売では電気、電子、化粧品用などが堅調に推移しました。なお、夏場の電力制限対策のため、顧客の前倒し生産による需要増の動きも見られました。また、海外では機能製品が堅調に推移した一方で、汎用品が市場価格低迷の影響を受けました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ0.4% (1億2千5百万円) 増加し355億2千5百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ1.0% (8千7百万円) 増加し91億7千4百万円となりました。

機能性化学品事業

セルロース誘導体は、国内事業が工業用製品や医薬用製品を中心に堅調に推移しました。ドイツのSEタイロース社は、建材用や塗料用製品で欧州市場をはじめとした需要の回復により堅調でした。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ6.5% (12億6千3百万円) 増加し207億6千9百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ16.2% (4億8千5百万円) 増加し34億8千3百万円となりました。

半導体シリコン事業

半導体シリコンは、東日本大震災による白河工場被災の影響を受けましたが、当社は他拠点での増産や在庫品の出荷を行うとともに、全力を挙げて白河工場の復旧に取り組み、6月末には被災前の生産能力水準に回復いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ4.3% (29億4千1百万円) 減少し662億4千5百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ10.8% (10億1千7百万円) 増加し104億4千4百万円となりました。

電子・機能材料事業

希土類磁石は、省エネルギータイプのエアコン向けや、FAモーター向けの出荷が好調でしたが、原料価格の急激な上昇の影響を受けました。フォトレジスト製品は、半導体デバイスの微細化の進展もあり堅調に推移し、高輝度LED用パッケージ材料も大きく伸ばいたしました。合成石英製品は、液晶用大型フォトマスク基板の出荷が堅調でしたが、光ファイバー用プリフォームは震災による鹿島工場の操業停止の影響を受けました。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ6.6% (22億1千2百万円) 増加し359億8千2百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ3.7% (3億3千1百万円) 増加し92億8百万円となりました。

その他関連事業

信越ポリマー社の携帯電話用キーパッドが、スマートフォン（高機能携帯電話）のタッチパネル化の影響などもあり低調に推移しましたが、半導体ウエハー関連容器は回復基調となりました。エンジニアリング事業は低調でした。

この結果、当セグメントの売上高は、前年同期に比べ23.6% (74億2千万円) 減少し240億4千2百万円となり、営業利益は、前年同期に比べ27.3% (6億3千8百万円) 減少し17億3百万円となりました。

(2) 連結業績予想に関する定性的情報

今期の見通しにつきましては、世界経済は緩やかな回復の動きが続くものと期待されるものの、予断を許さない状況にもあります。そのような中で国内では東日本大震災の影響による電力使用制限などもあり、先行き不透明な状況が予想されます。

当社グループは、直面する厳しい事業環境を乗り切るため、世界の幅広い顧客に積極的な販売活動を展開するとともに、特長ある製品を開発し新たな需要を開拓してまいります。また、技術や品質の向上に注力するとともに、原材料の安定的な確保に努めるなど、磐石な事業基盤の構築をめざしてまいります。

未公表でありました平成24年3月期の連結業績につきましては、以下の通りを予想しております。

また、配当金につきましては、中間、期末共に前期と同額の1株当たり50円と予想しております。これにより、年間合計の配当予想は前期と同額の1株当たり100円となります。

連結業績、及び配当の予想は、本日、別途「業績予想および配当予想に関するお知らせ」においても開示しております。

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	520,000	△2.4	77,000	1.1	82,000	1.0	50,000	△19.8	117.76
通期	1,065,000	0.6	155,000	3.9	165,000	2.9	102,000	1.9	240.23

※当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた記述であり、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績等は、様々な要素によりこれら業績見通し等とは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績等に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績等に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	244,002	261,583
受取手形及び売掛金	270,499	251,139
有価証券	116,714	97,888
たな卸資産	188,283	208,361
その他	70,962	65,239
貸倒引当金	△2,534	△2,413
流動資産合計	887,927	881,799
固定資産		
有形固定資産		
機械装置及び運搬具(純額)	252,229	257,576
その他(純額)	368,104	375,931
有形固定資産合計	620,334	633,508
無形固定資産	14,020	14,580
投資その他の資産		
投資その他の資産	261,921	263,247
貸倒引当金	△38	△37
投資その他の資産合計	261,883	263,209
固定資産合計	896,238	911,298
資産合計	1,784,166	1,793,097

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成23年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成23年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	110,753	111,667
短期借入金	8,712	9,027
未払法人税等	21,072	8,537
災害損失引当金	24,401	19,099
その他の引当金	2,433	2,035
その他	82,061	86,684
流動負債合計	249,434	237,052
固定負債		
長期借入金	5,548	5,564
引当金	14,498	15,132
その他	45,255	47,845
固定負債合計	65,302	68,542
負債合計	314,737	305,595
純資産の部		
株主資本		
資本金	119,419	119,419
資本剰余金	128,177	128,177
利益剰余金	1,376,043	1,378,651
自己株式	△40,917	△40,919
株主資本合計	1,582,724	1,585,329
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,275	1,641
繰延ヘッジ損益	895	1,004
為替換算調整勘定	△160,087	△143,216
その他の包括利益累計額合計	△155,916	△140,571
新株予約権	3,822	3,395
少数株主持分	38,798	39,347
純資産合計	1,469,429	1,487,501
負債純資産合計	1,784,166	1,793,097

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
売上高	259,715	250,023
売上原価	198,609	185,620
売上総利益	61,106	64,402
販売費及び一般管理費	24,966	24,400
営業利益	36,140	40,001
営業外収益		
受取利息	727	756
持分法による投資利益	3,874	2,131
その他	2,916	3,304
営業外収益合計	7,518	6,192
営業外費用		
為替差損	3,920	3,581
その他	709	377
営業外費用合計	4,629	3,959
経常利益	39,029	42,235
特別損失		
災害による損失	—	5,307
特別損失合計	—	5,307
税金等調整前四半期純利益	39,029	36,927
法人税、住民税及び事業税	9,455	9,804
過年度法人税等	△10,663	—
法人税等調整額	4,082	2,995
法人税等合計	2,873	12,799
少数株主損益調整前四半期純利益	36,155	24,127
少数株主利益	455	289
四半期純利益	35,700	23,837

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益	36,155	24,127
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5,718	△1,822
繰延ヘッジ損益	△139	△33
為替換算調整勘定	2,806	16,808
持分法適用会社に対する持分相当額	708	950
その他の包括利益合計	△2,343	15,903
四半期包括利益	33,812	40,031
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	33,283	39,182
少数株主に係る四半期包括利益	528	848

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

報告セグメントの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

1. 当第1四半期連結累計期間(自平成23年4月1日至平成23年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)	連結財務諸 表計上額
	塩ビ・ 化成事業	シリコーン 事業	機能性 化学品事業	半導体 シリコン事業	電子・機能 材料事業	その他 関連事業	計		
売上高									
外部顧客への 売上高	67,457	35,525	20,769	66,245	35,982	24,042	250,023	—	250,023
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,185	1,148	2,053	0	816	15,779	20,984	(20,984)	—
計	68,642	36,674	22,823	66,246	36,799	39,821	271,007	(20,984)	250,023
セグメント利益 (営業利益)	6,059	9,174	3,483	10,444	9,208	1,703	40,074	(73)	40,001

(注)セグメント間取引消去によるものです。

2. 前第1四半期連結累計期間(自平成22年4月1日至平成22年6月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							調整額 (注)	連結財務諸 表計上額
	塩ビ・ 化成事業	シリコーン 事業	機能性 化学品事業	半導体 シリコン事業	電子・機能 材料事業	その他 関連事業	計		
売上高									
外部顧客への 売上高	70,389	35,400	19,506	69,186	33,770	31,462	259,715	—	259,715
セグメント間の内部 売上高又は振替高	4,183	1,042	1,565	0	679	17,199	24,670	(24,670)	—
計	74,573	36,442	21,071	69,187	34,449	48,662	284,386	(24,670)	259,715
セグメント利益 (営業利益)	3,101	9,087	2,998	9,427	8,877	2,341	35,834	306	36,140

(注)セグメント間取引消去によるものです。

各セグメントに属する主要製品・サービス

セグメント	主要製品・サービス
塩ビ・化成事業	塩化ビニル樹脂、か性ソーダ、メタノール、クロロメタン
シリコーン事業	シリコーン
機能性化学品事業	セルロース誘導体、金属珪素、ポバール、合成性フェロモン
半導体シリコン事業	半導体シリコン
電子・機能材料事業	希土類磁石(電子産業用・一般用)、半導体用封止材、LED用コート材、フォトレジスト、マスクブランクス、合成石英製品、液状フッ素エラストマー、ペリクル
その他関連事業	樹脂加工製品、技術・プラント輸出、商品の輸出入、エンジニアリング

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。